

# 官能検査の自動化

## －世界をリードする品質はこうして生まれる！

開催期日：平成15年10月24日(金)  
申込締切：平成15年10月17日(金)

主催：精密工学会

企画：事業部会企画第2グループ

協賛：大田区産業振興協会/RP産業協会/SME東京支部/応用物理学会/計測自動制御学会/研削砥石工業会/研磨布紙協会/自動車技術会/全日本プラスチック製品工業連合会/素形材センター/ダイヤモンド工業協会/超硬工具協会/電気加工学会/砥粒加工学会/日本液晶学会/日本オプトメカトロニクス協会/日本金型工業会/日本機械学会/日本木型工業会/日本金属学会/日本金属プレス工業協会/日本光学会/日本光学測定機工業会/日本工具工業会/日本工作機器工業会/日本合成樹脂技術協会/日本小型工作機械工業会/日本材料学会/日本セラミックス協会/日本塑性加工学会/日本鍛造協会/日本ダイカスト協会/発明協会東京支部/プラスチック成形加工学会

国内の製造技術・生産ラインの海外シフトにより、海外では製造コストの低減に重点が置かれています。一方、国内製造ラインについては品質により重点が置かれ、常に高いレベルで品質保証されることが必要とされています。このような環境下において、自動車・半導体・液晶ディスプレイ等あらゆる分野の生産ラインにおける品質の“曖昧さ”を排除して、高い品質を維持する技術を確保しなければなりません。とくに生産ラインでの官能検査は古い時代から人間系が関与し、高い品質を維持してきました。しかし、製品の多品種・少量生産化と様々な新技術開発が進む中で、より複雑かつ高い品質を維持していくためには、技能に依存する官能検査では十分に対応できなくなりました。そこで、本講演会では官能検査を自動化した事例を取り上げ、官能検査における自動化の基本から生産ラインでの適用例まで、各分野で活躍されている講師の方々から、最新技術と将来技術動向について分かりやすく解説していただきます。

日時：平成15年10月24日(金) 10時00分～16時30分

会場：中央大学理工学部後楽園キャンパス 新3号館 10階 31008 大会議室

(〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27)

\* 後楽園駅(営団地下鉄丸の内線、南北線)下車徒歩約5分 \* 春日駅(都営地下鉄大江戸線、三田線)下車徒歩約5分

\* 水道橋駅(JR総武線)下車徒歩約10分

\* 会場URL:[http://www.tamacc.chuo-u.ac.jp/chuo-u/access/k\\_map.html](http://www.tamacc.chuo-u.ac.jp/chuo-u/access/k_map.html)

司会：高松 浩司(株式会社東芝)、大谷 幸利(東京農工大学)

### 次第(予定)

時間	題目	内容	講師
10:00～10:10	挨拶		
10:10～11:10	官能的処理を超える －自動外観検査における 取り組み－	欠陥の分布傾向識別や、歩留りインパクト推定など、いわゆる官能的処理の類の判断が自動化され出している。最近是非外観的欠陥の検出の重要性も指摘されており、新たな発展が期待される。これらについて解説する。	株式会社日立製作所 生産技術研究所 技師長  中川 泰夫
11:10～12:00	自動車内外装部品の 官能定量化	品質の向上と低コスト化を目指し各種の内外装部品について官能を定量化する研究が進められている。官能の定量化により、製品開発の指針を得たり検査の自動化を進めることが可能となる。ここでは各種の部品の中から色・質感に関するいくつかの研究事例について紹介する。	株式会社豊田中央研究所 第16研究領域  鈴木 和彦
12:00～13:00	昼食		
13:00～13:50	水溶性切削油及び洗浄液 における液体濃度計(屈折計)、pH計の活用	水溶性切削油や洗浄液は濃度を適正に管理することで、作業性、仕上がりなどを著しく向上できる。また、使用中の液の性状はpH値で管理することができる。金属加工の品質アップにつながる濃度及びpH計測器の上手な活用方法について紹介する。	株式会社アタゴ 企画部マーケティング課長  井上 正清
13:50～14:40	携帯電話の自動検査	携帯電話は機能が高度化・多様化していく中で、高品質・低価格な製品をタイムリーに供給していくことが重要である。量産初期からの品質安定化を狙った全自動検査ラインと官能検査の自動化手法について紹介する。	三菱電機株式会社 生産技術センター 量産化技術推進部  笹井 浩之
14:40～14:50	休憩		
14:50～15:40	液晶ディスプレイのムラ 検査技術と品質	液晶ディスプレイの品質は画質の美しさが追求される時代に入ってきた。ここでは人間工学的アプローチによる官能検査の定量化について紹介する。また、ムラの尺度としての“ものさし”(SEMIのスタンダード)についても紹介する。	インターナショナルディスプレイ テクノロジー株式会社 品質保証部  森 由美
15:40～16:30	CMP研磨パッドの表面 性状の評価	CMP研磨パッドの表面性状は研磨性能を左右する重要な因子であるが、使用状態で簡便な評価が困難であった。研磨パッド表面の2値化画像を用いた、簡便な研磨パッド表面性状の評価方法について紹介する。	株式会社日立製作所 生産技術研究所 プロセス ソリューション研究部  小島 弘之

定 員:80名(先着順で定員になり次第締切ります)

参 加 費:会員(賛助会員および協賛団体会員を含む)20,000円, 非会員 30,000円【会員・非会員ともテキスト代込み】  
学生会員 無料(ただしテキストご入用の場合は, 4,000円をご負担ください),  
学生非会員 6,000円(テキスト代込み) \*参加費・テキスト代とも消費税を含みます。

資 料:資料のみ, または聴講者で2冊以上ご希望の場合, 1冊 4,000円

申込締切:平成15年10月17日(金)

申込方法:申込書に必要事項をご記入の上, 郵送またはFAXにて受け付けます。

申込先:(社)精密工学会

(〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-5-9, 九段誠和ビル 2F, 電話 03-5226-5191, Fax 03-5226-5192)  
(学会ホームページ <http://www.jspe.or.jp> からも申込出来ます。)